

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2025-022

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	线上参与公司 2025 半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 9 月 12 日 13:00
地点	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荏 董事、总经理：肖佐楠 董事会秘书：龚小刚 财务总监：张海滨 独立董事：权小锋
投资者关系活动主要内容介绍	2025 年 9 月 12 日 13:00 至 14:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2025 半年度业绩说明会。公司董事长郑荏先生首先致词，向广大投资者报告了公司 2025 半年度经营情况。随后，公司管理层与投资者进行了线上交流。主要内容如下： 1、公司强调推动 AI 与量子技术与现有产品融合。请问在汽车电子（如高端域控芯片 CCFC3009PT）和量子安全芯片（如抗量子密码卡）方面，目前有哪些具体的研发突破、客户导入或量产计划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司车载高性能 RISC-V AI MCU 芯片产品 CCFC3009PT 采用 RISC-V 架构 6+6 核设计，内置 NPU 子

	系统，支持虚拟化技术，集成网络节点硬件路由模块，创新存储器与安全设计，该芯片已完成设计，即将进行流片验证。公司积极发展量子安全技术和产品，重点围绕量子安全芯片和模组、抗量子安全芯片和模组进行研发和产业化应用，目前已基于量子随机数发生器开发了多款量子安全芯片、终端应用量子安全模组、服务器和云应用量子安全模组，在智能终端、电力系统、电子政务、视频监控等多个领域有着广泛的应用前景。公司的量子安全相关产品已实现对外供货，向国内量子信息安全领域的多家厂商开展产品销售，包括中电信量子、问天量子 and 合肥硅臻等。公司与参股公司信大壹密成功研发的抗量子密码芯片 AHC001 是基于国产 28nm 工艺制程，并采用国芯科技 CPU 内核设计的一款可重构低功耗抗量子密码算法芯片。该芯片可以同时支持传统密码算法和抗量子密码算法应用，内部集成了抗量子密码算法引擎、ECC 引擎以及对称密码处理器。抗量子密码算法引擎采用可重构电路技术实现，具备低功耗、算法可重构、高安全性以及高扩展性特点，可用于多种应用领域产品的高安全防护，适用于今后对安全要求较高的各种端和边缘侧设备场合，可以广泛应用于金融、通信、电力、物联网等有高安全要求的信息安全设备中，可作为公钥基础设施（Public Key Infrastructure, PKI）参与数字安全基础设施建设，助力保障新时代数字经济发展。目前，公司正在和合作方基于该款抗量子密码芯片积极结合特定领域的信息安全密码保护升级需要进行产品和方案开发。作为国内领先的信创和信息安全芯片及模组研发企业，公司始终致力于研发并丰富公司的量子安全产品线。谢谢！ 2、公司上半年亏损略有扩大，三费占比上升明显。在研发高投入（营收占比 89.9%）的战略下，公司将通过哪些具体措施（如优化人员结构、库存管理等）来控制运营成本，以期尽快实现盈利？ 答：尊敬的投资者，您好！2025 年，公司存货管理工作持续深化。在库存盘点核查方面，公司扩充库房面积、优化库存空间布局，提高盘点效率。在盘盈盘亏分析方面，公司基于统计数据进行分析。
--	---

	挖掘和分析，优化细化成本核算，确保各类存货成本的准确计量，为公司成本控制与定价策略提供可靠依据。为优化库存管理，公司从销售端获取订单开始，便会结合库存情况、生产周期以及市场需求预测，对生产进行准确计划。对于长账龄库存商品，公司根据实际市场情况制定有针对性的销售策略，提高产品的销售速度，提升存货周转率。同时，公司从多方面积极推进降本增效工作的落实，严格控制成本和支出，努力提升产品的毛利率。谢谢！ 3、公司汽车电子芯片收入同比增长 63.81%，累计出货超 1700 万颗。面对国际竞争，公司如何进一步提升中高端 MCU、DSP 芯片的市占率？以及“MCU+套片”方案的具体推广进展和预期贡献如何？ 答：尊敬的投资者，您好！在汽车电子芯片领域，公司继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，公司将在现有市场和客户基础上依托技术优势，发挥自主 MCU、混合信号驱动芯片、通信接口芯片与传感器芯片的套片优势，为客户提供完善且具成本竞争力的整体解决方案，进一步扩大市场占有率。例如：（1）公司推出了声学 DSP 芯片系列 CCD5001/CCD4001/CCD3001，该系列芯片采用 12nm 先进工艺技术设计和生产，已有多家客户在实际开发应用中。该产品可广泛用于汽车音频放大器、音响主机、主动降噪 ANC/RNC、后座娱乐和数字驾驶舱等。（2）公司已成为国内最先同时拥有汽车安全气囊主控芯片、点火芯片和加速度传感器芯片的芯片厂商，基本实现汽车安全气囊芯片组的国产化替代，将为国内车企在安全气囊供应链安全提供重要支持。作为国内首颗获得 TÜV 北德 ISO 26262 ASIL-D 功能安全产品认证的安全气囊点火驱动芯片，CCL1600B 芯片在 2025 年 7 月初中标 4600 万元，已在多家整车厂实现装车应用和批量出货，并有多家客户完成了 DV/PV 实验，公司的 MCU 芯片在安全气囊控制器产品已实现稳定批量应用，在安全气囊控制器单点装车应用中超过 300 万颗，充分证明了其卓越的安全性和可靠性。广汽集团与国芯科技联合开发的气囊点火芯片正在
--	---

	推进上车应用。同时，公司与包括国际安全气囊头部企业在内的多家合作伙伴积极推进安全气囊芯片的创新与应用，已取得较为显著的进展。谢谢！ 4、2025 年上半年，公司研发的重要新产品有哪些？这些新产品目前应用的进展怎么样？ 答：尊重的投资者，您好！2025 年上半年，公司先后推出的重要新产品包括超高性能云安全芯片 CCP917T、抗量子密码芯片 AHC001、抗量子密码卡 CCUPHPQ01、汽车电子安全气囊点火芯片 CCL1800B，实现了公司在云安全、抗量子密码和汽车电子领域的新突破。其中，超高性能云安全芯片 CCP917T 的 SM2 签名效率达到 100 万次/s，对称算法性能达到 80Gbps，达到行业先进水平，满足国家三级及以上等保要求，具有广泛的应用前景。这些重要的芯片目前均已向客户送样，客户正在进行应用开发工作，目前各项工作进展顺利。谢谢！ 5、公司 RAID 芯片进展如何，今明两年能否批量化应用并贡献收入？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 RAID 存储控制芯片和模组产品已实现实际市场的应用销售，一方面，公司自主研发的 CCRD3304 芯片已成功导入移动通信基站、信创服务器等多个项目中；另一方面，某头部视频监控设备厂商成功导入 CCUSR6104 RAID 卡。除此之外，某国家重大需求项目已经选型公司 CCUSR8116 RAID 卡。谢谢！ 6、公司 AI 业务的布局与进展情况怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的 AI 业务包含定制 AI 芯片业务和自主 AI 芯片业务。公司定制 AI 芯片业务目前在手订单充足，上半年由于受外部因素影响生产周期加长，导致影响交付和收入的形成，截至 2025 年 8 月 27 日，定制 AI 业务的供应链已改善，正在积极组织相关芯片生产和交付等工作。公司自主 AI 芯片业务目前包括 AI MCU 芯片、AI 云安全芯片等，均基于 RISC-V CPU 技术进
--	---

	行研发。公司 AI MCU 芯片 CCR4001S 目前已在家电的主动感知与节能控制、婴儿看护的隐私友好监护、工业检测、光伏拉弧检测以及电机控制等场景落地验证，并与生态伙伴联合推出 AI 传感器模组，帮助客户加速量产导入、降低系统成本、缩短开发周期。公司车载高性能 RISC-V AI MCU 芯片产品 CCFC3009PT 采用 RISC-V 架构 6+6 核设计，内置 NPU 子系统，支持虚拟化技术，集成网络节点硬件路由模块，创新存储器与安全设计，该芯片已完成设计，即将进行流片验证。公司超高性能 AI 云安全芯片 CCP917T 的 SM2 签名效率达到 100 万次/s，对称算法性能达到 80Gbps，内置 NPU 子系统，达到行业先进水平，满足国家三级及以上等保要求，具有广泛的应用前景。此外，公司正在基于参股公司江原科技国产自主 AI 算力芯片和公司自有 CCT02 TCM 可信芯片开发可信 AI 推理卡，该可信 AI 推理卡支持国密 SM2/3/4 算法，支持静态启动度量功能，防止客户在使用软件的过程中可能会遭遇破坏或者黑客的恶意攻击，保护敏感信息不被窃取或不被恶意代码使用，可以满足《GM/T 0012-2020 可信计算》标准。同时公司积极布局 AI NPU 技术研发。在 NPU 领域，公司和香港应科院、龙擎视芯等单位合作面向端/边缘侧应用开展 AI 技术研发，开发 CNN20、CNN100、CNN200 和 CNN300 系列化 NPU IP 核，其中 CNN20 和 CNN100 已完成设计验证并可以对外授权，CNN200 和 CNN300 正在研发中。面向 AI PC 应用，公司和参股公司龙擎视芯正在合作开发 CNN300 NPU IP 核，CNN300 以标量运算单元和矢量运算矩阵相结合，利用专用重构化可编程技术，形成通用可编程形式的人工智能加速体，单核性能将可达 8TOPS，CNN300 具有多核一致性接口 MLS，支持多个 CNN300 IP 核之间扩展实现更高算力，保障单任务多核情况下数据流的同步和统一，如利用四核堆叠将实现 32TOPS 算力；MLS 接口也支持多颗集成 CNN300 IP 核的 SoC 芯片之间进行数据一致性同步，使得 SoC 芯片能够利用 chiplet 机制实现多核多芯片算力堆叠效果。CNN300 将支持 INT8/FP8/FP16 等常规 AI 应用所需要的数据类型，支持传统的 CNN、
--	---

	RNN 应用，也能支持最新流行的 LLM（大语言模型）应用；相比于传统 ASIC 形式 NPU 加速器，CNN300 具有灵活可重构和高性能高带宽低功耗特点。未来公司将积极拥抱 AI 技术，根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将 AI 技术研究成果积极应用到公司现有的汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品上，持续提升公司汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品的智能化水平，进一步提高公司产品的核心竞争力。谢谢！ 7、公司研发的 RISC-V 指令架构 CPU 内核目前的进展情况怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！自 2017 年以来，公司一直在致力于研发具有自主知识产权的高性能低功耗 RISC-V 架构的嵌入式 CPU 技术，公司成功研发了 CRV0、CRV4/CRV4E/CRV4H/CRV4L、CRV5、CRV7 系列 RISC-V CPU IP 核，并且都有国产化软件开发工具链支持。其中：CRV4E 在 CRV4 的基础上针对电机控制应用扩展了 DSP 指令；CRV4H 是符合功能安全要求的处理器，该处理器性能可对标 ARM 公司的 Cortex-M4 版本。另外，公司还基于 RISC-V 指令架构开展神经网络扩展指令集架构研究，在 RISC-V 处理器上运行扩展自定义指令，形成神经网络处理器专用指令集，能够支持神经网络算法的加速处理，并用于 CRV4AI 和 CRV7AI 处理器的实现。与国际公司合作开发适用于汽车电子高端域控支持虚拟化应用的 CRV6 CPU IP 核；与赛昉科技合作，公司完成 CRV9 CPU IP 核引进合作以及与北京开芯院合作，完成 CRV9H IP 核引进合作，可满足高性能计算的应用需要。谢谢！ 8、在汽车电子数模混合领域公司的业务布局和发展策略是怎样的？ 答：尊敬的投资者，您好！在汽车电子数模混合领域，公司集成化混合信号设计平台趋于成熟，已成功研发安全气囊点火芯片、PSI5 通信芯片、加速度计传感器芯片、门区驱动芯片、线控底盘电
--	--

	磁阀驱动芯片、BLDC 芯片，配合公司系列汽车电子 MCU，形成较强性价比的“MCU+”混合信号套片解决方案，增强了汽车电子芯片产品市场竞争力，随着汽车电子进一步向高压化、智能化发展，混合信号芯片将成为连接模拟世界与数字系统的关键纽带，其技术创新将深度影响整车能效、功能安全与用户体验，公司尝试构建 48V 混合信号芯片设计平台，CCL1800B 是公司面向 48V 架构成功研发的首款安全气囊点火芯片，实现业界首发，作为 48V 安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白，以该芯片为基础，公司搭建 48V 混合信号芯片设计平台，平台化布局初步成型并支撑后续多应用领域扩展，公司将持续加强在汽车电子数模混合信号领域的耕耘。谢谢！ 9、公司为什么要研发 48V 汽车电子芯片产品，目前进展怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！随着新能源汽车智能化进程加快，传统 12V 低压系统已难以满足新一代智能功能的功率需求。48V 系统以其更高的功率承载、更优的能效表现和更强的功能安全保障，成为汽车电气架构升级的关键路径。公司积极应对这一发展趋势，尝试构建 48V 混合信号芯片设计平台，CCL1800B 是公司面向 48V 架构成功研发的首款安全气囊点火芯片，实现业界首发，作为 48V 安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白，实现了新能源汽车安全气囊点火应用电子电气系统架构领域的创新与突破。以该芯片为基础，公司搭建 48V 混合信号芯片设计平台，平台化布局初步成型并支撑后续多应用领域扩展。谢谢！
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 9 月